

片式多层金属化薄膜电容器

Type: **ECP(A)**

使用电介质树脂和内部电极 (A_l) 的多层结构

■ 特点

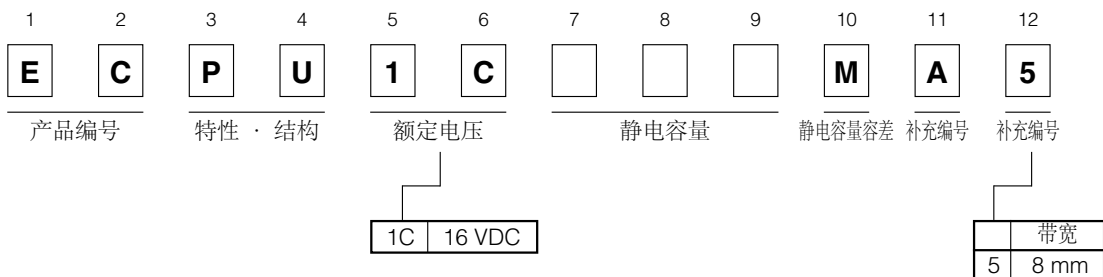
- 低ESR
- 小巧, 大容量
- 回流焊专用
- 已应对 RoHS 指令

■ 主要用途

- 用于降噪电路
- 用于音频电路



■ 型号命名方式

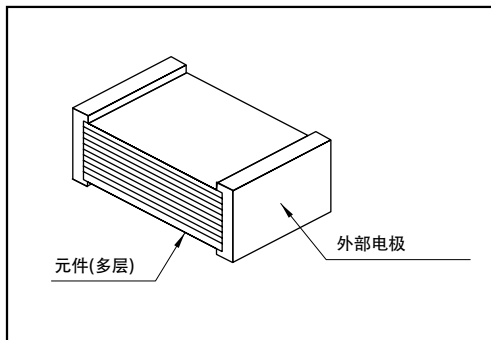


■ 规格

类别温度范围 (含电容表面自行升温)	- 40 °C to +85 °C
额定电压	16 VDC
静电容量范围	0.10 μF to 1.0 μF (E6)
静电容量容差	±20 % (M)
介质损耗因数 (tan δ)	tan δ ≤ 1.5 % (20 °C, 1 kHz)
耐电压	端子间: 额定电压 (VDC) × 175 % 1 s to 5 s
绝缘电阻 (IR)	C ≤ 0.33 μF : IR ≥ 1000 MΩ (20 °C, 10 VDC, 60 s) C > 0.33 μF : IR ≥ 300 MΩ · μF (20 °C, 10 VDC, 60 s)
焊接条件	回流焊: 高温峰值: 240 °C, 220 °C 以上 60 秒以内 (元件表面温度)

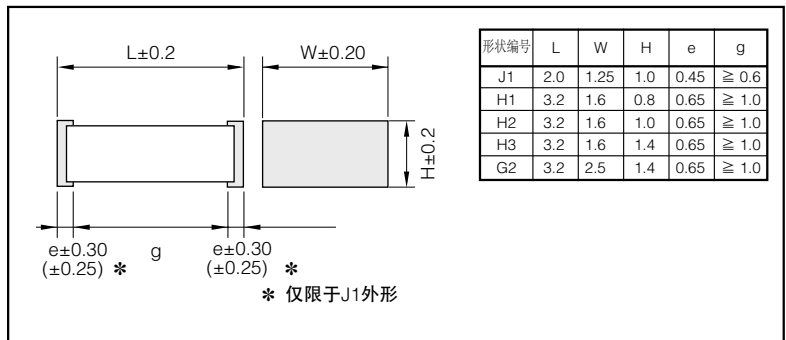
※以交流状态 (商用频率 50 Hz, 60 Hz 的正弦波) 使用 DC 额定电压产品时, 请参照「DC 额定电压产品的交流可用电压」页。

■ 结构图



■ 尺寸图

(单位: mm)



■ 自动贴装用编带包装规格

请参照自动贴装用编带包装规格页。

■ 额定规格, 尺寸及数量

型 号	静电容量 (μF)	尺寸 (mm)				包装数量
		L	W	H	形状编号	
ECPU1C104MA5	0.10	2.0	1.25	1.0	J1	3000
ECPU1C154MA5	0.15	3.2	1.6	0.8	H1	
ECPU1C224MA5	0.22	3.2	1.6	0.8	H1	
ECPU1C334MA5	0.33	3.2	1.6	1.0	H2	
ECPU1C474MA5	0.47	3.2	1.6	1.4	H3	2000
ECPU1C684MA5	0.68	3.2	1.6	1.4	H3	
ECPU1C105MA5	1.0	3.2	2.5	1.4	G2	

■ 推荐焊盘图案

(单位: mm)

形状编号	焊盘尺寸		
	回流焊		
	A	B	C
J1	0.8	2.4	1.1
H1	1.8	3.6	1.4
H2	1.8	3.6	1.4
H3	1.8	3.6	1.4
G2	1.8	3.6	2.3

※推荐焊盘图案不能保证在所有贴装条件下均能毫无问题地进行贴装。